

2011年12月9日

## SICAS 統計の 2011 年第 3 四半期(7-9 月)の数値公表

SICAS 統計(世界半導体生産キャパシティ統計)の 2011 年第 3 四半期(7-9 月)の数値がまとまりましたので公表致します。生産能力の数字は断りのない限り 8 インチウェハ換算の数字です。

### 【総括】

2011 年第 3 四半期(3Q)の IC 合計(MOS IC+バイポーラ)の生産能力は 1783.7 千枚/週となり、2011 年第 2 四半期(2Q)の 1726.8 千枚/週からは+3.3%の増加となった。一方、同 3Q の IC 合計の稼働率は 91.3%であり、前期(2Q)の 92.2%と比べると-0.9%ポイント低下した。

2011 年 3Q の半導体合計(IC 合計+ディスクリート計)の生産能力は 1988.9 千枚/週となり、前期(2Q)の 1932.6 千枚/週からは+2.9%の増加となった。一方、同 3Q の半導体合計の稼働率は 90.6%であり、前期(2Q)の 92.2%と比べると-1.6%ポイント低下した。

### 【概要】

#### 1. 生産能力

MOS 計の 2011 年 3Q の生産能力は 1740.7 千枚/週となり、前期(2Q)の 1679.4 千枚/週から+3.6%増加した。

#### 2. 稼働率

MOS 計の 2011 年 3Q の稼働率は 91.7%であり、前期(2Q)の 92.4%と比べると-0.7%ポイント低下した。

#### 3. ウェハサイズ別まとめ

MOS 計に占める 8 インチウェハの生産能力は、2011 年 3Q は 432.9 千枚/週となり、前期(2Q)の 439.9 千枚/週からは-1.6%の減少となった。また、12 インチ(300 mm)ウェハの同 3Q の生産能力は、8 インチ換算で 1181.1 千枚/週(12 インチ実枚数では 524.9 千枚/週)となって前期(2Q)からは+6.6%の増加、また同稼働率は 96.6%(前期比+1.0%ポイントの上昇)の高水準を示した。

(参加会社を含む諸データの詳細は別添をご参照ください。)

### 【データ収集】

SICAS に参加している IC 製造企業は、年 4 回、四半期毎に、その IC 生産能力と実投入数を地域別に委託した第三者のデータ集計機関に提出し、そこで集計された数値は最後に中央集計機関によりまとめられ、世界計の集計データとなり発表されます。

データの秘密保持のため、会員を含むいかなる関係者(データ集計機関を除く)も、公表される「世界計のデータ」以外を知り得ない仕組みとなっています。

参加会員は、各々自社の世界全体の生産能力と実投入数を連結ベースで把握し報告しますが、他の IC 製造企業に生産委託している部分は含みません。生産能力・実投入数のいずれもウェハ枚数を単位とし、集計期間内の総数を週当たりの平均値に換算し「千枚/週」の単位で報告します。報告方法は、以下のとおりです。

(1) 半導体合計 = IC 合計 + ディスクリート合計

(2) IC 合計 = MOS IC + バイポーラ IC の体系となります。( \* インチ換算にご注意ください。 )

MOS IC は、加工精度により 0.7 ミクロン以上、0.4 ミクロン以上 0.7 ミクロン未満、0.2 ミクロン以上 0.4 ミクロン未満、0.12 ミクロン以上 0.2 ミクロン未満、0.08 ミクロン以上 0.12 ミクロン未満および 0.08 ミクロン未満に分けて 8 インチウェハの枚数に換算、バイポーラ IC は加工精度の分類はなく、5 インチウェハの枚数に換算。また、2007 年 3Q より 0.12 ミクロン未満の項目を 0.08 ミクロン以上 0.12 ミクロン未満および 0.08 ミクロン未満と 1 つの項目から 2 つの項目とし、更に 2009 年 3Q より 0.08 ミクロン未満の項目を 0.06 ミクロン以上 0.08 ミクロン未満および 0.06 ミクロン未満と 2 つの項目としました。

MOS IC 生産能力のうち 8 インチウェハと 12 インチウェハの生産能力および実投入数のデータも併せて集計。また生産能力については、1 年 = 52 週、1 週 = 7 日、1 日 = 24 時間の稼働を前提とします。

#### 【組織概要】

SICAS は、世界の 5 業界団体 (EECA、JEITA、KSIA、SIA、TSIA)<sup>注1</sup> の支援の下に、1994 年に活動を開始し、現在世界の主要な半導体製造企業 19 社<sup>注2</sup> が会員として参加しています。

SICAS の運営組織は、会員から選出された代表者で構成されておりますが、SICAS への参加は任意であり、いかなる半導体製造企業 (4 つの支援業界団体のいずれにも属さない企業も含む) に対してもオープンです。四半期毎に公表される SICAS 統計は、参加会員だけでなく誰にでも入手可能です。

なお、日本地域の運営組織として、SICAS Japan が 1995 年 1 月に設立され、2006 年 4 月からは、JEITA 傘下で SICAS 小委員会として活動しております。

(注1)

- |   |              |
|---|--------------|
| ・ EECA : European Electronic Component Manufacturers Association            | (欧州電子部品工業会)  |
| ・ JEITA : Japan Electronics & Information Technology Industries Association | (電子情報技術産業協会) |
| ・ KSIA : Korea Semiconductor Industry Association                           | (韓国半導体産業協会)  |
| ・ SIA : Semiconductor Industry Association (of the US)                      | (米国半導体工業会)   |

(注2)

TSIA: Taiwan Semiconductor Industry Association (台湾半導体産業協会) が、本年春に SICAS を退会。

#### 【お問い合わせ先】

SICAS 小委員会 (SICAS-Japan)

事務局: (社) 電子情報技術産業協会 半導体部会 電子デバイス部

電話: 03-5218-1061

URL: <http://www.jeita.or.jp>